

## Varianten für das Erzeugen passender Footprints

**Variante 1** - Auswahl des Footprints aus vorhandener Bibliothek, wie in der Einführung Übungsteil A besprochen.

**Variante 2** - Erzeugen eines eigenen Footprints anhand der Footprintinformation des Bauelementeherstellers in einer eigenen Footprintbibliothek, wie in der Einführung Übungsteil B besprochen.

### Variante 3

Zugriff auf die Footprintbibliotheken der Firma Altium über die Internetadresse

<http://www.altium.com>

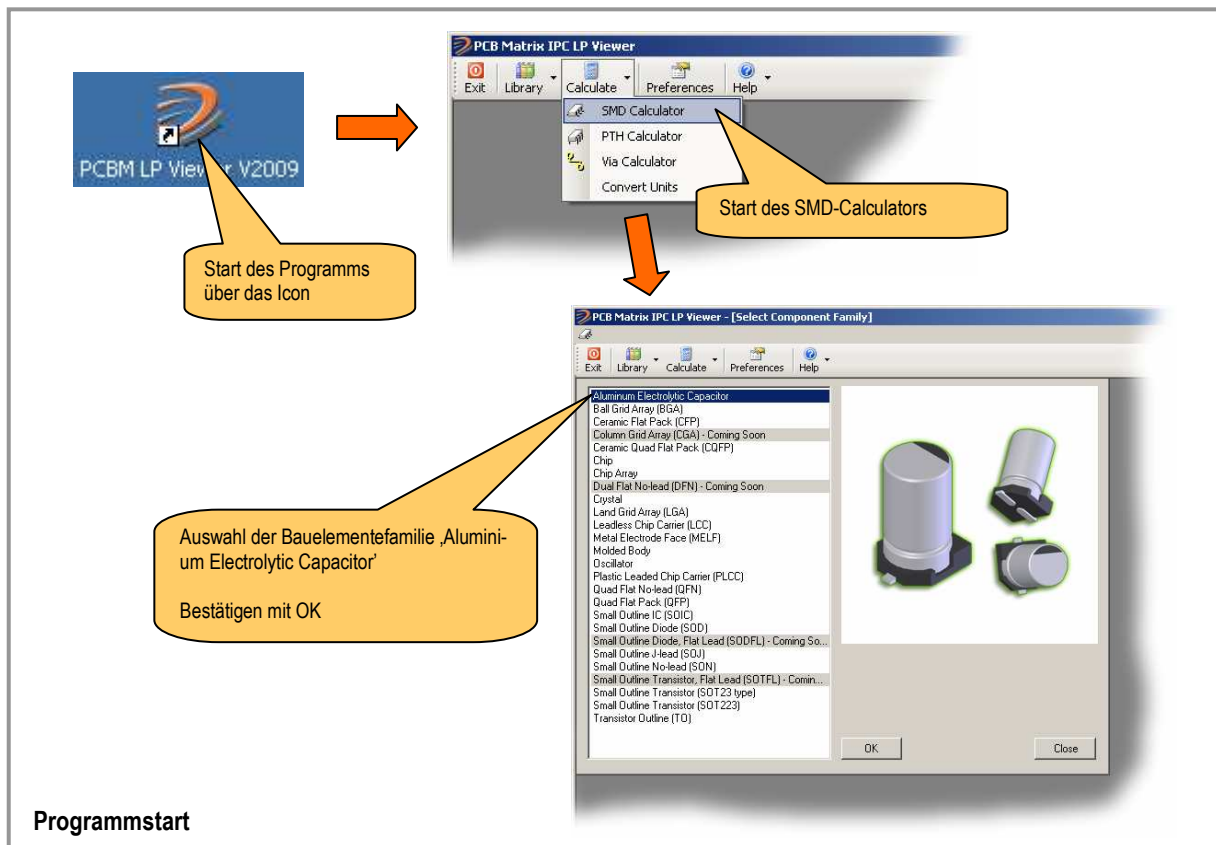
dort weiter über die Punkte

**Community → Libraries → Altium Designer 2004 Libraries  
→ Altium Designer footprint libraries**

Auf dieser Seite kann man Footprints suchen und Footprint-Bibliotheken herunterladen. Diese werden dann wie in der Anleitung besprochen in das eigene Projekt eingebunden.

### Variante 4

Erzeugen der Footprint-Informationen über das Programm ‚PCB Matrix LP Viewer V2009‘\*. Beispiel: Elektrolytkondensator Typ Panasonic EEEFK1H470P, Bauform ‚E‘.



\* Das Programm kann auch von der Adresse <http://landpatterns.ipc.org/> heruntergeladen werden.

**Auswahl ‚Find‘**

**Doppelclick auf passendes Bauelement**

CAPAE660:550N	Capacitor,Aluminum Electrolytic;6.60mm L X 6.60mm W X 10.00mm H	IEC SERIES 1680	IEC STD Packa
CAPAE660:570N	Capacitor,Aluminum Electrolytic;6.60mm L X 6.60mm W X 10.00mm H	CASE D2	EIA STD Packa
CAPAE660:600N	Capacitor,Aluminum Electrolytic;6.60mm L X 6.60mm W X 10.00mm H	IEC SERIES 1680	IEC STD Packa
CAPAE660:790N	Capacitor,Aluminum Electrolytic;6.60mm L X 6.60mm W X 7.90mm H	CASE D8	EIA STD Packa
CAPAE830:1020N	Capacitor,Aluminum Electrolytic;8.35mm L X 8.35mm W X 10.20mm H	CASE F	EIA STD Packa
CAPAE830:1050N	Capacitor,Aluminum Electrolytic;8.35mm L X 8.35mm W X 10.50mm H	IEC SERIES 1680	IEC STD Packa
CAPAE830:620N	Capacitor,Aluminum Electrolytic;8.35mm L X 8.35mm W X 6.20mm H	CASE E	EIA STD Packa
CAPAE830:680N	Capacitor,Aluminum Electrolytic;8.35mm L X 8.35mm W X 6.80mm H	IEC SERIES 1680	IEC STD Packa

**Auswahl der Registerkarte ‚Land Pattern‘**

**AbleSEN der Informationen für das jeweilige Footprint, Übertragen in den Altium Designer**

**Erzeugen der Footprint-Informationen**

**Achtung:** Bei allen diesen Varianten ist immer zu überprüfen, ob das Footprint zum jeweiligen Bauelement passt:

- Stimmt das Raster?
- Sind die Pads ausreichend groß (größer als der Bauelementanschluss, um Lötbarkeit zu gewährleisten)?
- Ist die Padfläche frei vom Bestückungsaufdruck?
- Sind die Bohrungen groß genug?
- Stimmt die Zählrichtung der Pins?